



発行：(株)吉岡精工

発行日：2011.11.29

第10号

Yoshioka Seiko news

～ お客様の“こんなものが欲しい”を形にします～

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-49

TEL 045-500-1363(代) FAX 045-500-1383

www.yoshioka.co.jp www.porous-chuck.com

[ポラスチャック専用サイト]

新製品「HoVaC(ホバック)」販売開始のお知らせ

2011年10月1日より、新製品「ホットバキュームチャック HoVaC(ホバック)」の販売を開始いたしました。

「ホットバキュームチャック HoVaC(ホバック)」は、ワークを吸着しながら加熱実験のできる世界で唯一の真空チャックです。内部にヒーターを組み入れることにより、全面の均一な加熱を実現いたしました。最大で250℃までの加熱ができる上、冷却機能を持たせているため、大気冷却に比べ急勾配での冷却を行うことが可能です。加熱によって生じるワークの変形にお困りの方は、是非お試し下さい。不良率削減に貢献いたします。

製品用途

- ・熱硬化によるウエハの張り合わせ
- ・ウエハレベルでのボンディング・テープマウンター・テープリムーバー
- ・常温から高温化でのチップ耐久テスト 等

製品紹介



HoVaC

注目の最新記事

(日刊工業新聞からの抜粋)

- ・ヒロセ電機、「横浜センター」完成 (11/16)
- ・高田工業所、超音波切断装置を発売 - 毎秒2.5mmでSiCを高速加工 (11/16)
- ・富士フィルム、韓国で半導体材生産 (11/18)
- ・タイ洪水/日本の工作機械、被害は1万台規模 - 修理・代替が必要 (11/18)
- ・タイ洪水/ソニー、中国のコンパクトデジタルカメラ工場生産調整 (11/21)
- ・ディスク、300mmウエハ対応のステルスダイシングレーザー発売 (11/22)
- ・東京エレクトロン、宮城と岩手の被災地に太陽光発電11基を寄贈 (11/22)

セミコン・ジャパン2011に出展いたします

2011年12月7日(水)～12月9日(金)、幕張メッセで開催される**セミコン・ジャパン2011**に出展いたします。吉岡精工は、デンカアドテックス株式会社様ブースに製品を展示させていただくことになりました。新製品HoVaCや、ガラス状カーボンを用いた真空チャック等のご紹介を予定しております。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

イベント詳細

日時 2011年12月7日(水)～12月9日(金)

会場 幕張メッセ

出展ブース ホール4 4D-805 (デンカアドテックス株式会社様 ブース内)

公式Webサイト <http://www.semiconjapan.org/ja/>

このニュースレターは、お取引先様、お問い合わせいただいたお客様、ならびに展示会等で名刺交換させていただいた皆様に向け、新製品、新技術、また展示会情報などの情報発信を目的として発信しています。個人情報に関しましては、弊社にて責任を持って管理し、Yoshioka Seiko newsの配信、弊社からの重要なお知らせの他、弊社事業活動に関わる以外での使用は致しません。